

関係各位

レンゴー株式会社
広報部

日本包装技術協会「第50回木下賞 包装技術賞」を受賞

レンゴー株式会社は、このたび、「打ち抜き工程を活用した工程集約型加飾技術『ブライトプレス』の開発」において、公益社団法人日本包装技術協会が主催する「第50回木下賞 包装技術賞」を受賞しましたのでお知らせいたします。

「ブライトプレス」は、木型を応用し、打ち抜き、エンボス加工を同時に行うことのできる加飾技術です。はっきりとしたエンボスの縁取り加工に印刷やニスを組み合わせることで、インパクトあるデザイン表現が可能です。

打ち抜き、エンボス加工をそれぞれ別の機械で加工する方法と比較して工程数が減り、製造にかかるエネルギーを節約できます。1カ所の生産拠点で対応できるため、生産工場間の配送が不要となり、CO₂排出量の削減にも貢献します。

当技術は、パッケージの表面への点字表示や持ちやすくするための凹凸加工にも応用でき、多様性を尊重する社会に向けたアクセシブルパッケージの実現を支えます。

当社は“Less is more.”をキーワードに、包装資材のソリューション開発を今後も継続し、持続的な経済社会の発展と人々の豊かな暮らしを支えてまいります。



打ち抜き工程を活用した工程集約型加飾技術「ブライトプレス」

【木下賞】

公益社団法人日本包装技術協会第二代会長 故 木下又三郎氏の包装界に対する多年の功績を記念して創設された表彰事業です。本賞は、毎年包装関連業界において、①包装の研究・開発 ②包装の改善・合理化 ③包装の新規分野創出について、顕著な業績をあげたものに対して授与される賞です。

以上